

Gudeng Precision Industrial Co. Ltd

家登精密工業股份有限公司



2025.03



Partner with **H.E.A.R.T.** , Grow with **P.A.S.S.I.ON.**

發言人：沈恩年 營運長 暨 發言人
電話：(02)2268-9141
郵件：AmyShen@gudeng.com



免責聲明

本資料可能包含對於未來展望的表述，是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知不確定性的影響，實際結果將可能於表述內容不同，以上所提供之所有資訊僅供參考，實際資料請參考公開資訊觀測站。

另除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。



家登-先進載具設備领航者



美國家宇

美國家登/德鑫半導體

韓國家登

日本家登

家登土城總部
家登創投
家登復興廠

協力廠重慶廠

上海

家登昆山廠

上海家登

家碩科技

家崎科技

家登樹谷廠

台南

朝宇航太

岡山

- 成立於：1998年3月20日
- 員工數：1100 up
- 實收資本額：NT 942,972,320
- 集團**2020**營業額：NT **25** 億元
- 集團**2021**營業額：NT **31.2** 億元
- 集團**2022**營業額：NT **44.9** 億元
- 集團**2023**營業額：NT **50.8** 億元 (與前年成長13%)
- 集團**2024**營業額：NT **65.5** 億元 (與去年同期成長29%)
- 主力產品：

半導體事業

- ① 光罩傳載解決方案
- ② 晶圓傳載解決方案
- ③ 半導體機台設備
- ④ 其他服務

航太事業

- ① 動力液壓阻尼油缸
- ② 液壓傳輸高壓導管
- ③ 動態平衡馬達基座
- ④ 正負壓熱傳導隔片



半導體產業展望

由於2025年全球人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求持續攀升，從雲端資料中心、終端裝置到特定產業類別，各個主要應用市場均面臨規格升級趨勢，半導體產業將再度迎來嶄新榮景，**預計2025年整體半導體市場將成長超過15%**。在AI晶片需求爆炸性成長之下，預估全球半導體市場將在2027年達到7,000-8,000億美元規模，且業界已有共識認為**2030年市場可望突破1兆美元**。

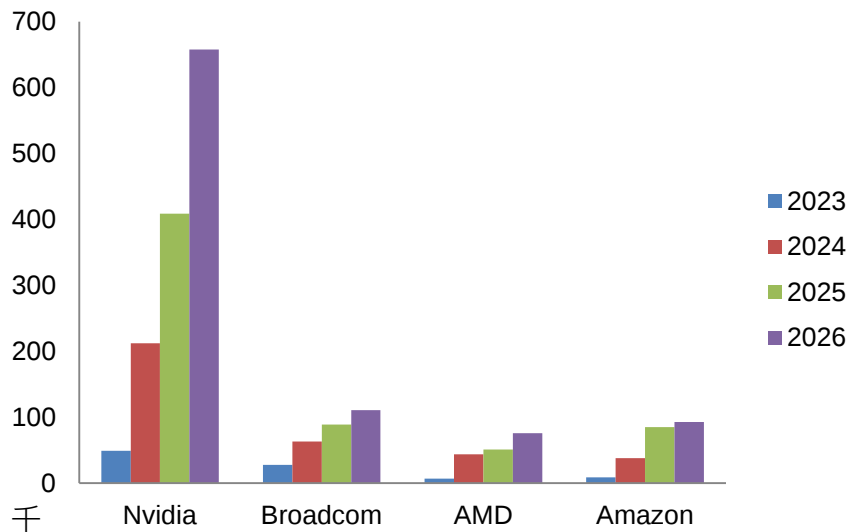
AI應用將加速邏輯晶片、記憶體與封裝技術發展，為求晶片整體性能與功耗效率提升，**CoWoS 先進封裝技術**在整合運算晶片與記憶體方面也扮演關鍵角色，反映出現代電子設計面臨的挑戰，半導體技術整合也更加關鍵。此外，散熱成為在高效率的運算系統下支撐電子產品穩定運作的重要一環，各廠開始規劃導入不同的散熱解決方案，帶動相關供應鏈發展。未來隨著**生成式AI、CoWoS以及其他高速運算應用對半導體技術的持續需求**，在**先進製程和3D封裝技術**方面將帶來顯著的市場增長。



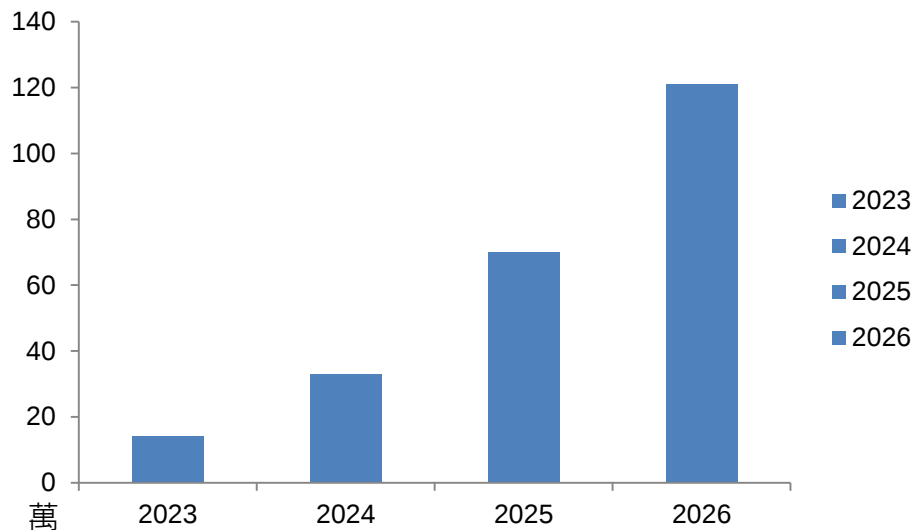
資料: 資策會MIC、IDC Research



CoWoS及主要 AI 晶片終端需求



關鍵客戶CoWoS產能預測



市場對於高運算晶片需求持續增加，關鍵客戶國內外先進製程布局，預估**2025年底CoWoS晶圓月產能可達7萬片，2026年底超過10萬片**。

資料: GFHK



關鍵客戶先進製程/封裝布局



家登精密

熊本廠 Fab23(P1~P2)

6/7/12/16/22/28 奈米

P1: 2024年底量產

P2: 2027年底量產

桃園

AP3

新竹廠

Fab20(P1~P4)

2 奈米

2025下半年量產

AP1(RD)

在美再投資**1000億美元**

未來將新增

3座晶圓廠

2座先進封裝設施

1座研發中心

德國德勒斯登廠

車用晶片

2027年量產

苗栗

AP6

華盛頓廠

Fab 11

德州

RD中心

嘉科廠

擴充先進製程

2026年量產

AP7

加州

RD中心

台南廠 Fab18(P1~P8)

5/4/3 奈米

AP2/ AP8 (2025年底啟用)

台中/中科廠

2 奈米

2027年完工

AP5

2025上半年啟用

亞利桑那廠 Fab21(P1~P3)

4/3/2 奈米

P1: 2024年底量產

P2: 2028年量產

P3: 2030年量產

高雄廠 Fab22(P1~P3)

2 奈米

2025下半年量產

資料: 中央通訊社/ 數位時代 彙總整理

Copyright© 家登精密工業股份有限公司著作權所有



半導體在地供應鏈聯盟



家登精密

聯盟	企業								美國據點
	廠務	材料	化學品	氣體	設備	測試	濾網	IT服務	
德鑫	-	家登集團 (家碩)	-	意德士	奇鼎 聖凰 科嶠 迅得	-	濾能	微程式	格蘭岱爾 亞利桑那州
德鑫貳	康淳	頌勝 維田 耐特 圓達	新應材	-	聯策 邑昇 印能 友威	-	-	-	
聖暉 大艦隊	朋億 聖暉 銳澤	-	-	-	-	-	-	-	準備中
G2C+ 聯盟	-	-	-	-	志聖 均豪 均華	-	-	-	準備中



半導體在地供應鏈聯盟_德鑫



「全球關鍵性材料及創新技術的整合服務商」
打造台灣半導體國家隊

家登精密

家登集團
(家碩)
3680/6953
邱銘乾 董事長
詹印豐 總經理

全球半導體載具
解決方案領航者

迅得
6438
王年清 董事長

高階製程機台儲存及
定位系統整合專家

家登持有8.86%

科嶠
4542
鄧全凱 董事長
吳明致 總經理

CoWoS載具
清洗設備領航者

家登持有7.57%

奇鼎
6849
鄭智文 董事長

精密製程
環境控制專家

家登持有1.72%

Ecosystem 一站式解決方案

整合上中下游客戶、供應商，
打造出兼具彈性與
效率的服務平台

EUV關鍵組件
提升良率專家

意德士
7556
關聖哲 董事長

先進製程超高潔淨及
無塵室環境濾材專家

濾能
6823
黃銘文 董事長

EUV光罩式精密感測
儀器製造供應商

微程式
7721
吳騰彥 董事長

家登持有7.99%

先進製程載具
微污染防治專業供應商

聖凰
周傳華 董事長



半導體在地供應鏈聯盟_德鑫貳



「全球關鍵性材料及創新技術的整合服務商」
打造台灣半導體國家隊

家登精密

Ecosystem 一站式解決方案

整合上中下游客戶、供應商，
打造出兼具彈性與
效率的服務平台

聯策

6658

林文彬 董事長

精密製程
檢測機台專家

維田

6570

李傳德 董事長

工業智能應用
智慧化工廠專家

頌勝

7768

朱銘癸 董事長

半導體關鍵
耗材供應商

新應材

4749

詹文雄 董事長

電子特用化學
材料供應商

圓達

莊明郎 董事長

半導體精密零件
檢測及研發專家

高科技電子純水系
統設計專家

康淳

林守堂 董事長

高階先進製程及封裝
關鍵材料供應商

耐特

陳勳森 董事長

家登持有5%

高頻高速及低損耗
之PCB應用專家

邑昇

5291

簡榮坤 董事長

先進封裝製程提升
良率專家

印能

7734

洪誌宏 董事長

半導體應用機台及
化學鍍膜專家

友威

3580

李原吉 董事長



大中華先進製程發展

中美貿易戰帶來地緣政治不確定性，美國政府祭出多項AI進出口限制，對出口先進晶片的代工廠和封裝公司實施更嚴謹要求，大中華地區客戶轉向積極發展先進製程提高在地產能

公司	地區	技術	月產能	公司	地區	技術	月產能
SMIC	上海	7 nm and below	50K	CXMT	合肥/北京	DRAM	300K
SMIC	北京	7 nm / 14 nm	50K	CXMT	上海	DRAM	>100K
華力	上海	7 nm	20K	YMTC	武漢	NAND	300K
華為	上海	7 nm	20K	YMTC	武漢	DRAM	50K
華為	深圳	7 nm / 14 nm	30-50K	Swaysure	深圳	DRAM	100K

大中華關鍵客戶產能規劃，先進製程月產能預計超過**15萬片**



2025年大中華半導體廠

山東省

- 芯恩 (青島) (8" /12")
- 青島物元(12")
- 濟南比亞迪(8")
- 擎方科技 (Blank)
- 濟南泉意(Mask)

浙江省

- 杭州積海(12")
- 富芯半導體(12")
- 浙江創芯(12")
- 杭州士蘭(8")
- 長電紹興(後段)

重慶市

- 重慶萬國(12")
- 潤西微電子(12")

江蘇省

- 南京台積(12")
- 無錫卓勝微(12")
- 無錫海力士(8" /12")
- 長電先進(後段)
- 蘇州矽科 (後段)
- 南京芯德(後段)
- 無錫中微(Mask)
- 無錫迪斯(Mask)

華為體系

成都市

- 成都路維(Mask)
- 成都比亞迪(12")

廣東省

- 深圳昇維旭(12")
- 深圳鵬新旭(12")
- 深圳鵬芯微(12")
- 東莞光茂(12")
- 廣州粵芯(12")
- 深圳中芯(12")
- 東莞銳信(後段)
- 廣州新銳光(Mask)
- 深圳路維(Mask)
- 深圳清溢(Mask)
- 珠海龍圖(Mask)

遼寧省

- Intel大連(12")

北京市/天津

- 北京中芯(12")
- 中芯京城(12")
- 長鑫集電(12")
- 北京燕東(8" /12")
- 賽萊克斯(8")
- 天津中芯(8")

上海市

- 中芯國際(12")
- 中芯東方(12")
- 上海光通信(12")
- 上海集成(12")
- 積塔半導體(8" /12")
- 台積電-十廠(8")
- 先進半導體(8")
- 上海凸版(Mask)
- 上海新昇(Wafer)
- 上海超硅(Wafer)

陝西省

- 西安奕斯偉(Wafer)

湖北省

- 武漢楚興(12")
- 武漢新芯(12")
- 武漢高芯(8")
- 長江存儲(12")

安徽省

- 長鑫新橋(12")
- 長鑫存儲(12")
- 合肥晶合(12")
- 合肥視涯(12")
- 合肥沛頓(後段)
- 合肥清溢(mask)
- 合肥合光(mask)

福建省

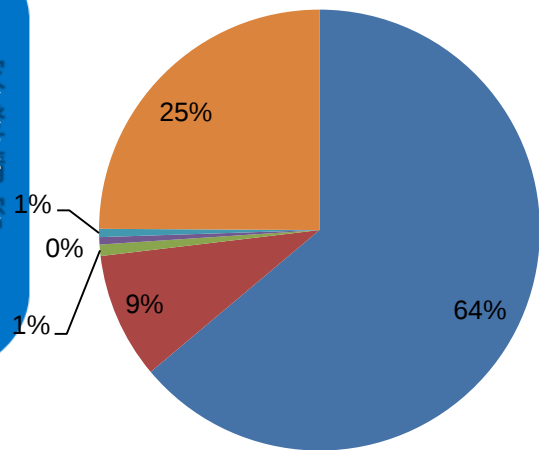
- 廈門聯芯(12")
- JHICC(晋华) (12")
- 廈門士蘭(12")
- 渠梁電子(後段)
- 廈門美日(mask)



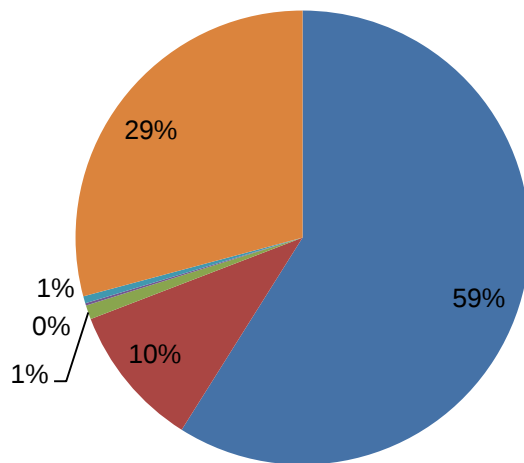
家登本業營收地區表現



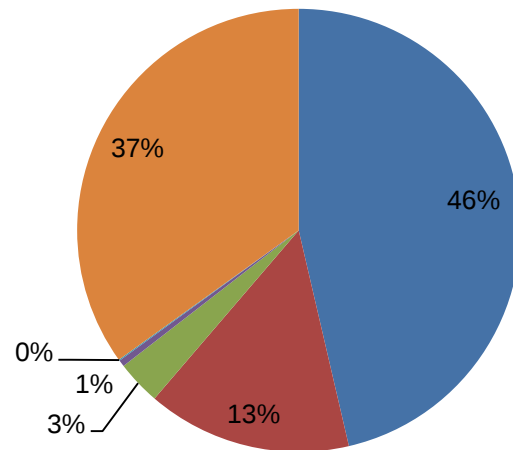
2022



2023



2024



■ 台灣 ■ 美國 ■ 日韓 ■ 其他 ■ 歐洲 ■ 大中華



半導體客戶分布

Logic/Power Foundry&IDM.



PCB/OSTA (Outsourced Semiconductor Assembly and Test)

Memory Foundry&IDM.



Reticle /Mask

Equipment





家登擴廠計畫

- 家登精密
- 重要客戶

日本久留米廠
半導體暨航太產能
2027年Q2完工

德國德勒斯登廠
ESMC

昆山廠/重慶協力廠
大中華半導體產能
昆山二期
大中華半導體產能
2024年10月啟用

TSMC熊本廠
Fab23(P1~P2)

TSMC台南廠
Fab18(P1~P8)

TSMC高雄廠
Fab22(P1~P3)

TSMC新竹廠
Fab20(P1~P4)

TSMC中科廠
Fab15

TSMC華盛頓廠

TSMC亞利桑那廠
Fab21(P1~P3)

復興廠
半導體產能
家崎大樓
Cooling生產暨研發總部
2025年Q2完工
龍福一、二廠
半導體暨航太產能
2025年Q4啟用

美國子公司
倉儲/ FAE
2024年1月啟用

家登樹谷廠
半導體及航太產能
家登樹谷廠二期(久久大樓)
半導體暨航太產能
無塵室(3F)2024年12月啟用
1F、2F、4F 2025年下半年投產

南科三期
半導體、航太及家碩產能
2029年Q1啟用

彰化花壇廠
新事業生產基地
2028年Q2完工



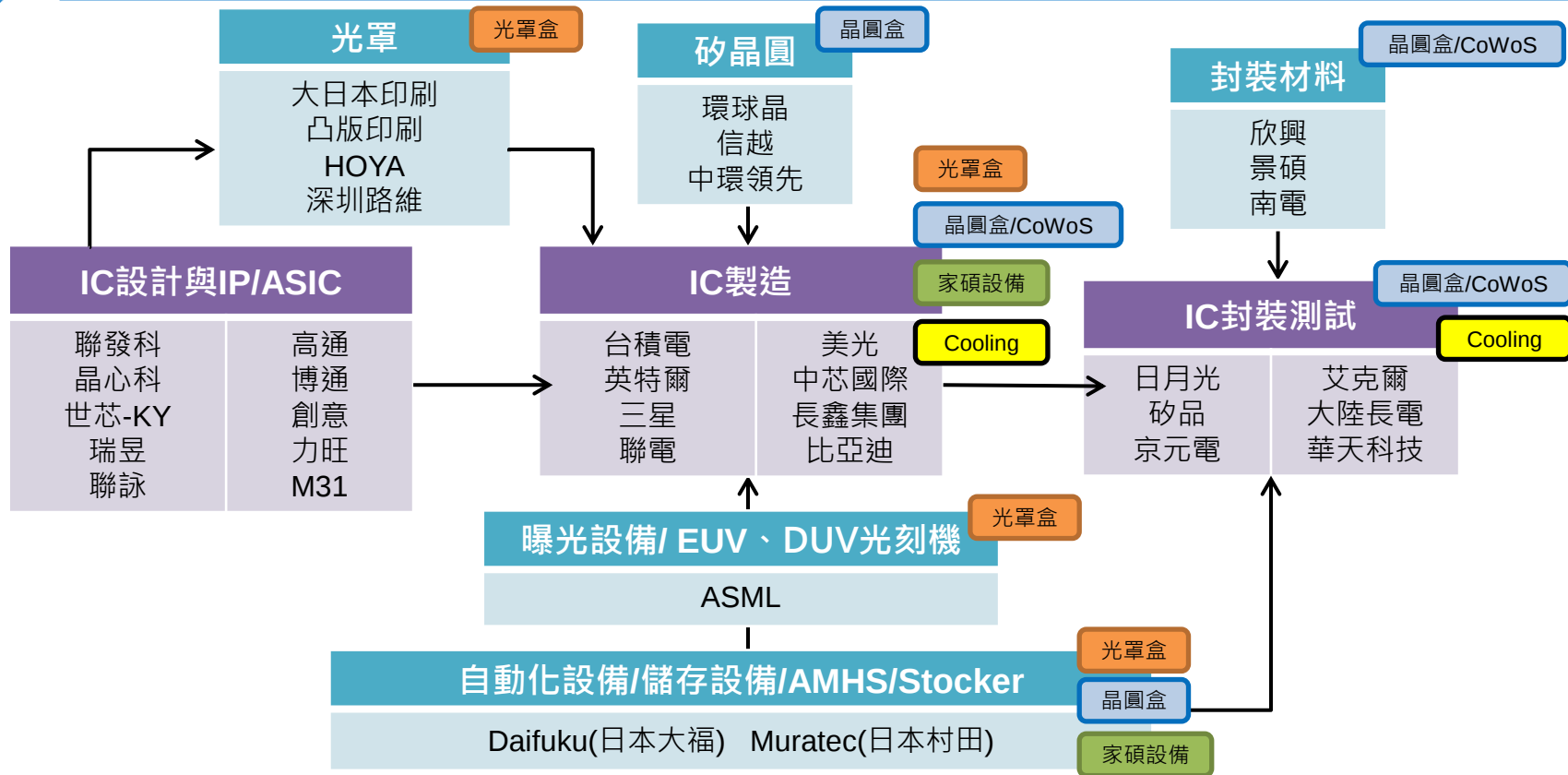
- AI
- 航太
- 通訊
- 汽車
- 消費電子
- 國防

半導體製程





半導體產業供應鏈





先進封裝技術-家登全系列解決方案

300 FOUP/FOSB

Film Frame FOUP

Film Frame
FOUP

2023

8"/12"

wafer processing
transport

Tape frame
FOUP

2025

SEMI
E185

300*300

wafer processing
transport



Full Panel
Shipper

2024

510*515

Horizontal Panel
shipping box

Quarter Panel FOUP

2021

2025

SEMI E62
(door)
E47.1 (shell)
E57 (KC)

243*241

300*300

¼ Panel product transport

Panel FOUP

410/450 Glass
Shipping Box

2025

Raw material
shipping box

Full Panel FOUP

SEMI E181

2025

2023

2022

600*600

510*515

510*510

Panel processing transport

IC Tray FOUP

SEMI E185

SEMI E47
SEMI E62

2017

2025

Tape Frame FOUP

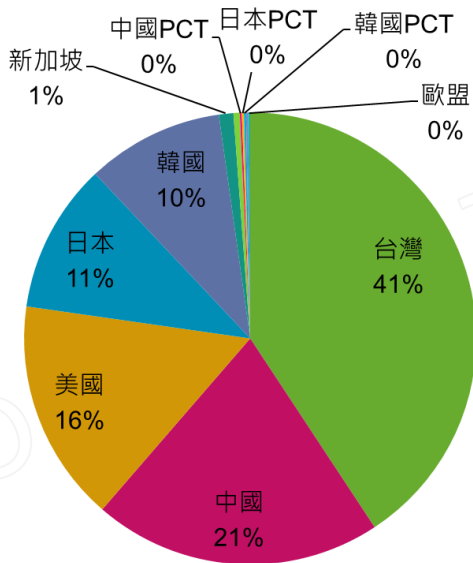
Tray FOUP

Tray & Magazine

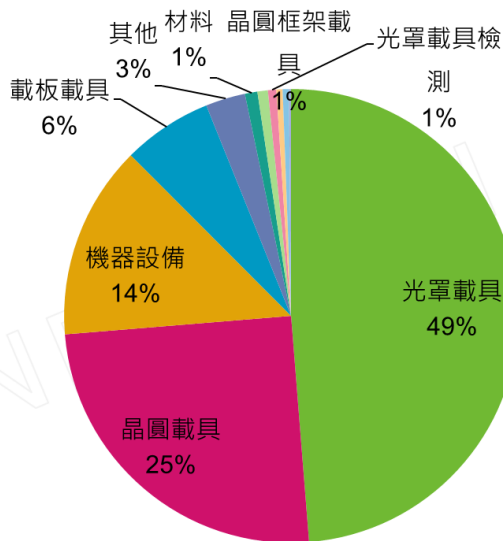
IC product transport



專利地區別



專利產品別



截至2025年3月，獲得國內外**702**項專利的肯定，持續建構高技術含量之專利版圖



家登發展藍圖-五大亮點



家登精密



「深耕關鍵客戶」
「開拓新客戶」
「發展新市場」
三大策略重點聚焦發展

「**協同創新Co-Creation**」
整合上中下游客戶、供應商
尋找優質併購標的
擴展集團事業體

2025 ~

EUV Pod

先進製程持續擴充，High-NA
EUV POD等相關需求量大



2025 ~

晶圓載具解決方案

全系列晶圓載具全球市佔不斷攀升，
先進封裝市占快速增加，成為大中
華關鍵客戶Baseline



2025 Q3 ~

先進封裝系列載具

完整CoWoS及後段先進封裝
解決方案領先全球



2026 ~

拓展新技術

持續研發Cooling、化學桶、濾
網等相關新技術，拓展新市場



2026 ~

航太事業

航太營收正式挹注，不斷擴充客
戶群，挑戰營收翻倍成長





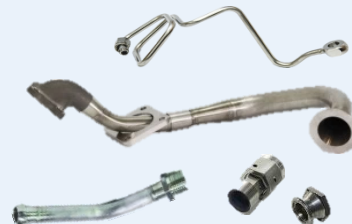
航太事業主力客戶



導管、逆止閥、緊固件
及相關加工零件，適用於GE引擎件



提供各式管件及連接管等，
更於廠內進行化工處理及
特殊焊接工段



航太事業起源
「高進入障礙」
「高毛利市場」
「精密加工」



不僅提供板金、加工零件
和管件接頭，更提供
塑膠射出產品



透過3~5軸車銑床加工技術，
提供控制液壓零件，
如缸體、腔體、活塞等

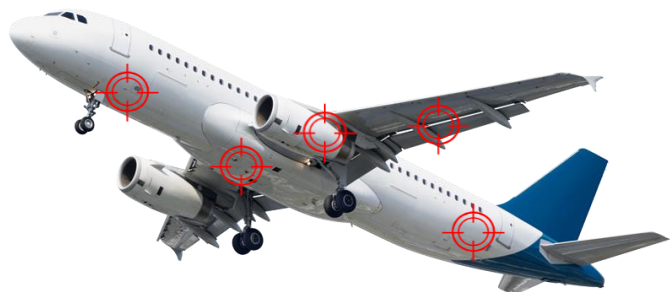




家登航太產品佈局



家登精密



液壓控制缸體&週邊
48% 市佔率



GE Aerospace

Honeywell

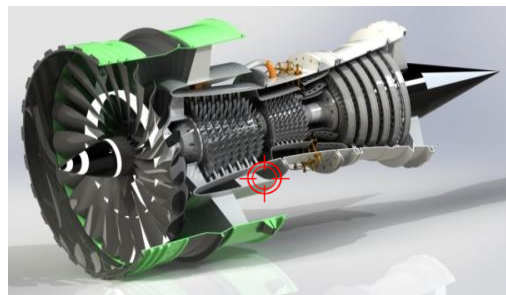
AEROSPACE



Pratt & Whitney

A United Technologies Company

傳輸燃油/冷卻液管&週邊
72% 市佔率





2025年航太事業展望



電控系統散熱 & 電系(塑膠)
37% 市佔率



機艙內飾(塑膠)
36% 市佔率



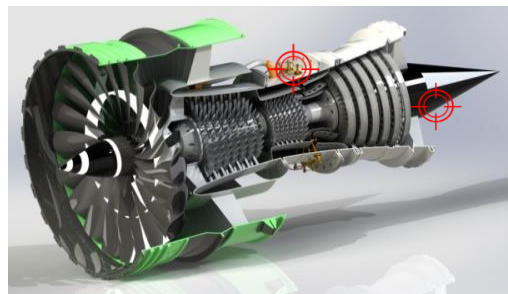
燃油機噴油系統
91%市佔率



GE Aerospace



飛機煞車懸吊系統
63%市佔率



高溫液氣體排放系統
42% 市佔率

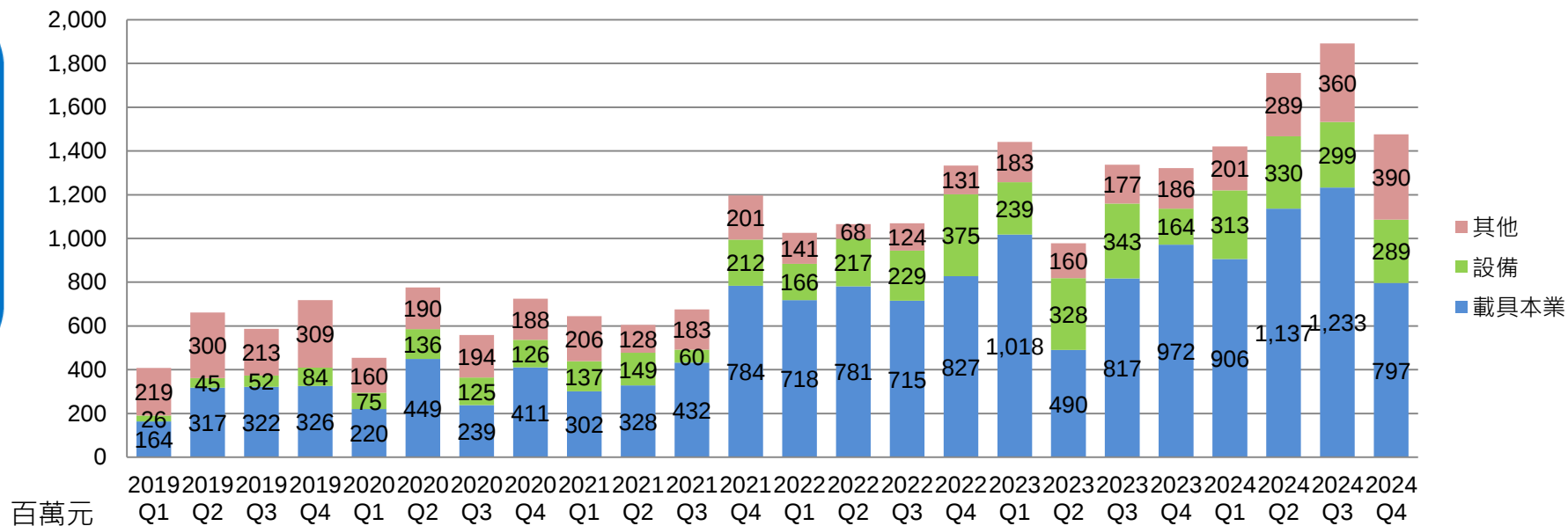


GE Aerospace



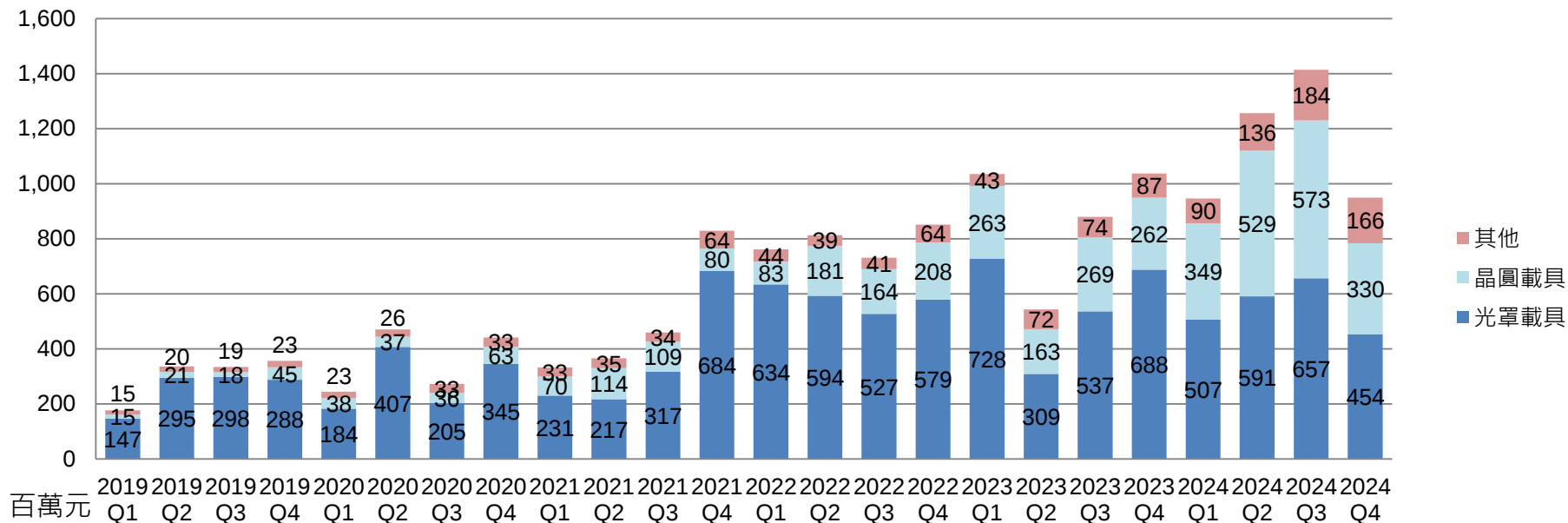


家登集團合併營收



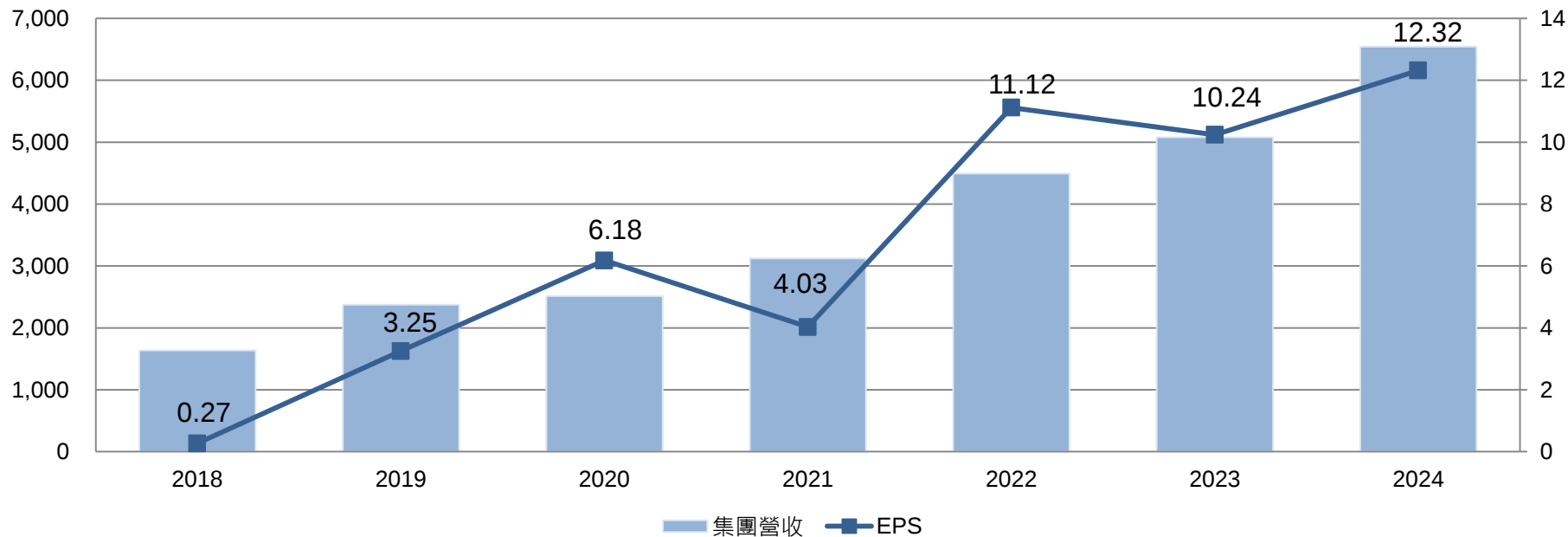


家登本業營收



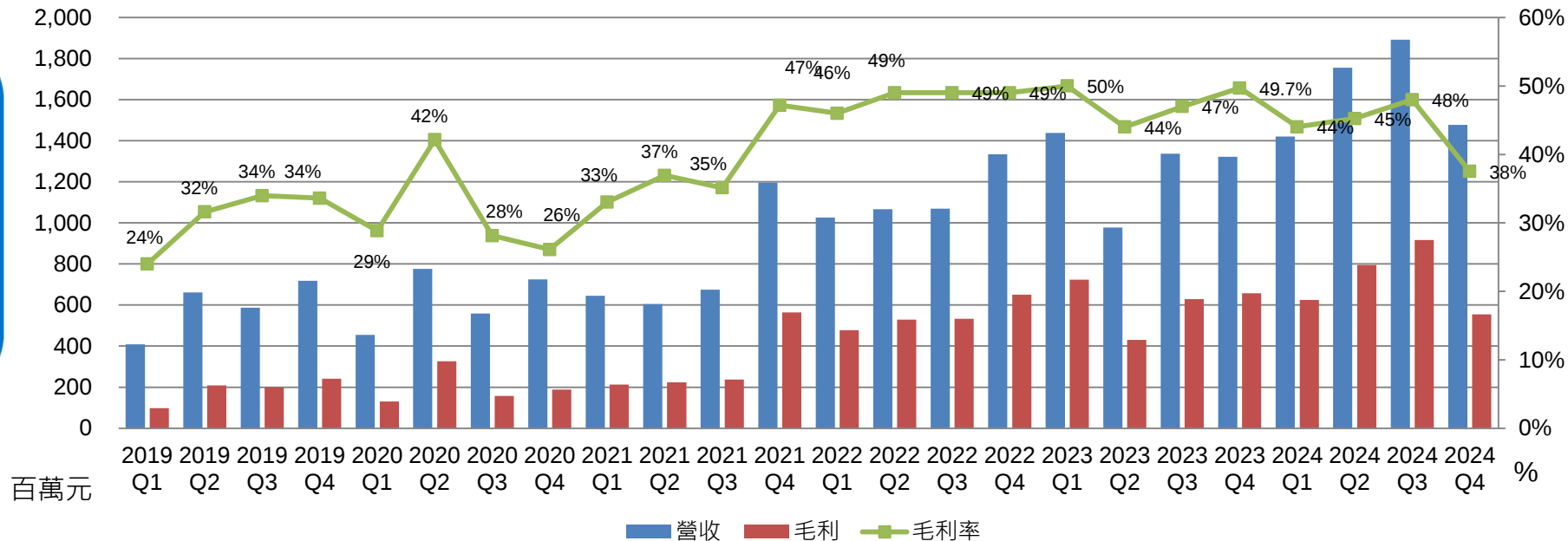


家登集團年營收/EPS





家登每季營收毛利





家登集團近五年營收、毛利率、資本支出及總資產

年度	年營收	毛利額	毛利率(%)	EPS	資本支出	資產總額
2019	23.7	7.5	32%	3.24	0.95	48.2
2020	25.1	8.0	32%	6.18	11.30	62.3
2021	31.2	12.4	40%	4.03	20.61	95
2022	44.9	21.9	49%	11.12	7.31	122
2023	50.8	24.4	48%	10.24	13.04	162.9
2024	65.5	28.8	44%	12.32	17.42	213.7

單位: 億元



家登集團近五年資本支出

年度	土地	建築物	建造中 不動產	機器設備	其他	合計
2019	0.26	0.38	-	0.14	0.17	0.95
2020	6.28	0.88	-	1.02	3.12	11.30
2021	14.53	0.38	2.83	1.69	1.18	20.61
2022	2.31	0.01	1.66	1.27	2.06	7.31
2023	2.05	0.22	5.61	2.77	2.39	13.04
2024	2.91	2.67	7.60	1.56	2.68	17.42

單位: 億元



家登集團費用及毛利率比較

	2024										2023				
	Q1	YoY %	Q2	YoY %	Q3	YoY %	Q4	YoY %	累計	YoY %	Q1	Q2	Q3	Q4	累計
營收	14.20	-1%	17.56	80%	18.94	42%	14.74	10%	65.45	35%	14.41	9.78	13.37	13.22	50.78
成本	7.95	11%	9.62	74%	9.77	39%	9.19	28%	36.54	38%	7.17	5.53	7.04	6.64	26.39
毛利額	6.25	-14%	7.94	87%	9.17	45%	5.55	-19%	28.91	31%	7.24	4.25	6.33	6.58	24.39
費用率	28%		23%		23%		30%		26%		20%	33%	30%	25%	27%
EPS	2.24		3.00		4.39		2.69		12.32		3.94	1.68	1.94	2.68	10.24

2024 費用說明:

- 隨著家登事業群跨大，因應成長需求組織擴編及併購，使得相關費用增加
- 大中華地區銷售大幅成長，進出口、樣贈費用及傭金費用增加
- 家碩科技機台需調機，故增加呆滯損失/現金增資，增加相關營業費用及營業成本
- 為增加廠內產能，購置相關模具、機台設備等，故逐期攤銷後每月折舊費用提高

單位: 億元



家登集團整體綜效



營收每年雙位數成長：

自2019年營收超越20億新台幣，2022年達45億元，2023年50.8億，截至**2024**營收達**65.5**億，較去年同期**成長29%**

穩定的毛利率：

2018年突破20%，2022年49%，2023年48%，**2024年44%**

EPS每年持續成長：

2018年為0.27元，2019年3.25元，2022年11.12元，2023年10.24元，**2024年12.32元**

全球載具市占率快速攀升：

光罩盒全球**市占超過70%**、EUV光罩盒**超過85%**、**FOUP晶圓盒**陸續通過大客戶認證，**大中華半數**以上客戶採用家登為baseline



家登ESG實踐績效



榮獲天下永續公民獎 中堅企業 永續百強
榮獲TCSA台灣企業永續獎 企業永續報告 白金級



ESG 評等摘要

上市櫃ESG評等

A

經濟

11-30%

社會

11-30%

環境

31-50%

揭露

11-30%

單位營收碳排量至

2023年減少**33%**
(以2021年為基期)



單位營收用水量至
2023年減少**54%**
(2021年為基期)

單位營收廢棄物至2023年
減少**21%** (2021年為基期)

次料循環利用專案，回收**再製棧板、運輸箱、人體工學椅**

2023年員工平均年薪**21**個月

2023年提供**185**個優質工作機會



2023年投入**17**項社會公益行動，效益達**1,600萬元**

2023年人均薪資福利費用
832,000元



導入ISO22301、ISO20400、ISO 27001

永續報告書
第1類白金級

獲得品質領域最高榮譽
27th 國家品質獎



永續綜合績效獎
台灣100大永續典範企業獎



家登集團成長藍圖

2025

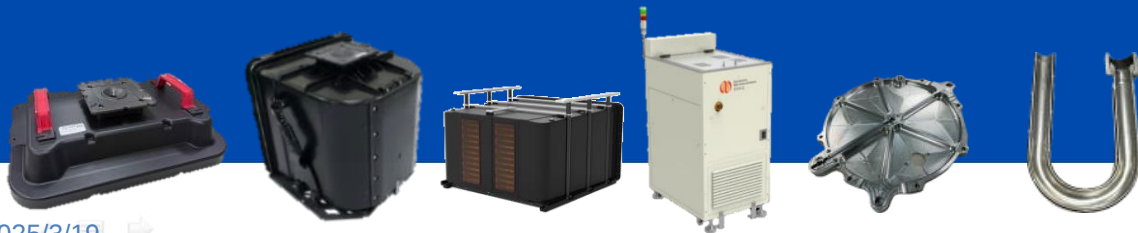
- ◆ 晶圓載具國內外市佔**持續擴張**，貢獻強力營收成長
- ◆ 聚焦先進製程，成為關鍵客戶主力供應商
- ◆ 配合CoWoS發展，3D封測(Panel FOUP) **出貨穩定提升**
- ◆ 半導體全方位解決方案領先市場，集團挑戰百億營收

2026

- ◆ 航太關鍵零組件持續驗證並取得長單
- ◆ CoWoS產品強烈挹注營收成長
- ◆ **High-NA EUV成熟量產**，帶來營收貢獻
- ◆ **Immersion Cooling Tank成熟量產**，貢獻強力營收成長
- ◆ 持續建廠擴充產能，完成全球大客戶在地供應及全方位服務

2027

- ◆ 獨家領先**先進封裝全新系列載具**市佔持續擴張
- ◆ 正式插旗**半導體耗材市場**，提供關鍵客戶完整系列產品
- ◆ 加速**擴展航太製程**，搶佔航太市場
- ◆ 持續聚焦高營收市場及併購策略，集團更上層樓





Thank You

www.gudeng.com